

C(K)X-600 Series

Advance Power Device Test Fixture

DIP&SMD 功率半导体器件测试夹具，适配 IWATSU CS-3200，Keysight B1506A 等半导体参数分析仪/曲线图仪。



前言

VAMTEK【J ELECTRONIC 子品牌】致力于为用户提供用于 SiC/GaN MOSFET 的高可靠性测试插座和适配 Keysight, Iwatsu 品牌半导体参数测试系统的专用测试夹具,专业工装,专业线材。

使用我们 JCx 系列的高可靠性测试插座和专用夹具,可以在测量过程中最大可能的释放 SiC/GaN MOSFET 的全部性能潜力,夹具采用与日本 JC 株式会社合作的专用连接器和器件固定材料,适合于常温与高低温条件下稳定评估各种 DIP 与 SMD 封装的器件静态参数;使用低电感测试座用于动态参数评估可能获得极佳的稳定数据。

JCx 准确评估 TO-3P 和 TO-247 封装功率器件的性能对于开发和制造至关重要。我们的测试插座提供创新技术和高可靠性,可最大限度地提高采用 SiC (碳化硅) 和 GaN (氮化镓) 等下一代半导体材料构建的 MOSFET 的性能。

我们的 CX 系列插座专为 **半导体静态参数、动态开关参数参数**, 以及器件 HTRB 可靠性测试而设计,即使在恶劣条件下也能保持稳定的电气和机械完整性。

高速开关信号-低 Ls 和开尔文精密测量评估

我们的测试插座旨在充分提取设备的高速开关性能并实现精确评估。我们的插座采用标准开尔文连接,可将电流测量路径与电压传感路径隔离开来。这消除了接线和接触电阻对压降的影响,确保了高精度的测量。

直插贴装 DIP 功率器件测试插座

通孔安装功率器件测试插座: 兼容 TO-247-4L、TO-3P 等

我们提供与 TO-247-4L 和 TO-3P 等通孔安装封装兼容的高性能测试插座的全面阵容。

我们的插座采用开尔文连接,能够准确评估 TO-247-4L 等封装中 MOSFET 芯片的高速开关性能。

此外,我们还提供能够处理最大 **DC 50A** 电流的高性能设计的产品。



> 了解更多 P

表面贴装功率器件测试插座: SiC/GaN 时代的高低温、高可靠,高电压,大电流,低电感。

我们提供与引起行业关注的新型表面贴装封装兼容的各种测试插座,例如 TOLL、QDPAK、R2PAK 和 HU3PAK。



> 了解更多 P



适配 IWATSU CS-3000/5000 系列半导体曲线图仪所有型号

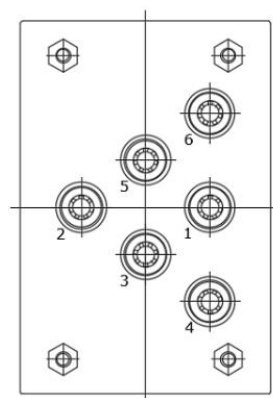


与“IWATSU CS-3000,CS-5000,CS-8000 兼容的 CX-600 半导体图仪适配器

- ◆ 适配 CS-3100、3200、3300、5100、5200、5300、5400、8020、8200、8500
- ◆ 能够测量功率器件的 IV 和 CV 特性。
- ◆ 支持包括 TOLx 等多种先进封装选配
- ◆ 支持 TO-247-3, 支持 TO-247-4 封装测试高温应用。
- ◆ 支持扩展 PHS-500 系统组成高温半导体参数自动测量系统。

测试插座规格和功能

1. IV 和 CV 特性测量：测量半导体器件的 IV 和 CV 特性。
2. 灵活的定制设计：专为适应任何设备而定制，包括具有独特要求的设备。
3. 即插即用设计：内部完全接线，可直接连接到您的测试设备。
4. 经济高效的解决方案：测试插座与标准产品共享组件，以优化性价比。

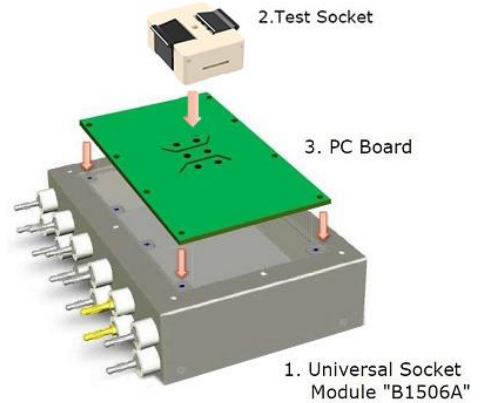


适配测试座示意图：

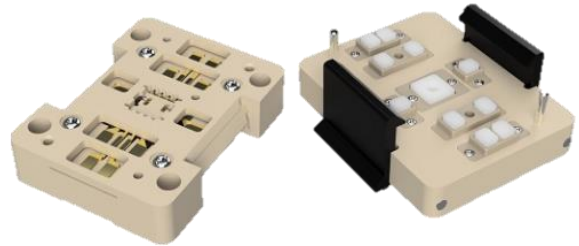
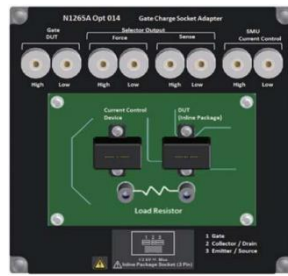
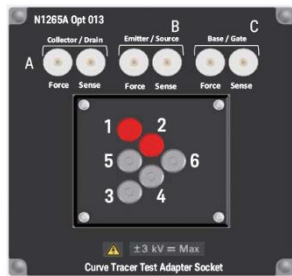




适配 Keysight B1505/ B1506A 系列功率半导体参数分析仪所有型号



- 与 Keysight B1506A 功率器件分析仪兼容 能够测量功率器件的 IV 特性和 CV 特性
- 测试插座、印刷电路板和校准虚拟器件的设计和制造
- 与各种器件形状兼容，包括 SMD（表面贴装器件）
- 支持脉冲：400A / DC：100A 的大电流。
- 通过最小化泄漏电流，它可以实现高精度测量。



测试插座规格和功能

实现大电流和低接触电阻。此外，泄漏电流最小化尽可能低的情况下，可以进行高精度测量。它与 TD-SON-8、ThinPAK8x8 和 PQFN 等封装兼容。测试插座可以共享触点组件，即使对于定制设计也具有成本效益。

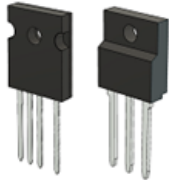
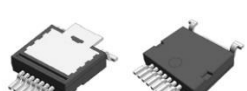
规格（典型值）	
额定电流	脉冲：400A / DC：100A
接触电阻	最大 5mΩ
介电强度电压	1000 伏
可接受的设备类型	TD-SON-8、薄型 PAK8x8、PQFN 等。

支持器件类型 (截止 2025 年 8 月)：

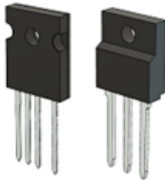
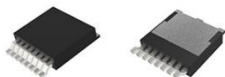
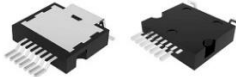
TO-247-3、TO-247-4、TO-220、TO-252(D-PAK) 、TO-263(D2-PAK) 、TO-263-7(D2-PAK) 、TOLL、TOLG、TOLG、HU3PAK、QDPAK、R2PAK。

支持与客户共同开发专用封装夹具。

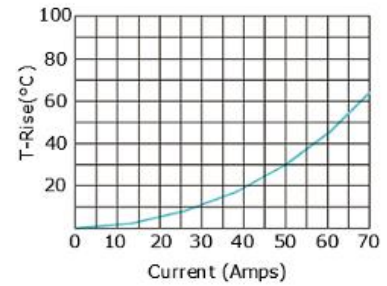
VAMTEK CX-600 系列定制测试座选型索引表 (IWATSU 岩崎通信机)

封装名与图例		测试座产品型号	适配 IWATSU 测试盒 型号
TO-247-3		CX-601-N	CS-301、CS-302、 CS-303、CS-304、 CS-322、CS-323、 CS-603、CS-605
TO-247-4		CX-601	
		CX-601-PH	
		CX-602	
		CX-602-H	
		CX-602-PH	
TOLL		CX-603	
CX-603-N			
TO-263(D2-PAK)		CX-604	
CX-604-N			
TO-263-7(D2-PAK)		CX-605	
CX-605-N			
TO-252(D-PAK)		CX-606	
CX-606-N			
TOLG		CX-607	
CX-607-N			
TOLT		CX-608	
CX-608-N			
HU3PAK		CX-609	
CX-609-N			
QDPAK		CX-610	
CX-610-N			
R2PAK		CX-611	
CX-611-N			

VAMTEK KX-600 系列定制测试座选型索引表（兼容 Keysight , Keithley）

封装名与图例		测试座产品型号	Keysight 适配盒
TO-247-3		KX-601-N	N1259A-013 N1259A-014 N1265A-013 N1265A-014
TO-247-4		KX-601	
		KX-601-PH	
		KX-602	
		KX-602-H	
		KX-602-PH	
TOLL		KX-603	
		KX-603-N	
TO-263(D2-PAK)		KX-604	
		KX-604-N	
TO-263-7(D2-PAK)		KX-605	
		KX-605-N	
TO-252(D-PAK)		KX-606	
		KX-606-N	
TOLG		KX-607	
		KX-607-N	
TOLT		KX-608	
		KX-608-N	
HU3PAK		KX-609	
		KX-609-N	
QDPAK		KX-610	
		KX-610-N	
R2PAK		KX-611	
		KX-611-N	

适配 SiC/GaN 型功率器件插座支持 DIP 的 TO-247-3, TO-247-4, TO-220



T-rise 电流图 (50A UHC 型曲线参考, 14 平方线)

低电感、宽温区、大电流

适配功率器件封装的测试 Socket / 冶具:

TO-247-4L、TO-247 等功率型插座

适用于苛刻测试环境和多样化产品阵容的鲁棒性

我们提供多种插座类型，以适应不同的设备评估条件:

- 大电流、高耐压型: 最大接触电阻为 20mΩ (*), 支持大电流功率器件的稳定测试。
- 高温高耐压类型可处理高达 220°C 的温度, 适用于极端热测试。
- 低释气类型使用 PEEK 等高性能绝缘体, 非常适合洁净室和敏感应用。
- 带有镀锡端子的类型可确保高电流能力, 同时提供卓越的性价比。
- 我们专门的高性能类型提供 DC50A 大电流能力, 非常适合最苛刻的应用。

这种广泛的选择使我们能够灵活地满足您不同的测试需求, 并实现可靠的数据采集。

* 包括通电引起的温升。

T3P/T4P 型可选测试座电气规格

	标准高性能	特殊规格	S/N 型
耐久性	10,000 次循环 *	10,000 次循环	5,000 次循环 *
额定电流	20A	5A(HT)\50A (UHC)	5/20A
接触电阻	最大 20 mΩ	最大 50 mΩ (220°C)	最大 20 mΩ
绝缘电阻	最小 500 MΩ	最小 500 MΩ	最小 500 MΩ
耐压	DC2500V 1 分钟, 25°C (最大 DC5000V **) AC2000Vrms 25°C 时 1 分钟 (D 和 S 之间)	DC4000V 1 分钟, 25°C (最大 DC5000V **) AC3000Vrms 25°C 时 1 分钟 (D 和 S 之间)	DC2500V 1 分钟, 25°C AC2000Vrms 25°C 时 1 分钟 (D 和 S 之间)
温度范围	-55 至 +175°C ***	-55 至 +220°C	-55 至 +105°C
结构材料			
绝缘材料	PPS	PEEK (低释气)	PPS
导体材料	主体低热铜合金	铜合金	钢或铜合金
导体材料工艺	镀金	镀镍	镀镍/镀锡

Power Transistor Test Sockets (For TO-220,TO-3P,TO-254,etc)

Power Transistor Test Sockets accommodate various packages and the sockets are compatible with using for high current, high withstand voltage and under high-temperature environment.

Suitable for packages including TO-220,TO-3P,TO-66,TO-247,TO-254,TO-262,TO-264.
(Some package might not be usable. Please call us)

PC Board Mounting Type

High Current Type
High Voltage Type
High Temperature Type
Kelvin Contact Type

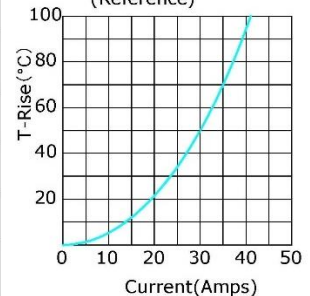


Specifications		High current type High voltage type		High temperature type High voltage type	
P/N		T3P-L214-ST-BK	T3P-L214-ST-BK-P	T3P-L214-ST-HT	T3P-L214-ST-HT-P
Materials	Insulator	PPS Black	PEEK (Low Outgassing)	PPS Black	PEEK (Low Outgassing)
	Contact	Copper Alloy Au plating over Ni plating		Stainless Steel Au plating over Ni plating	
Mating Durability		10,000 cycles*			
Current Rating		20A		5A	
Contact Resistance		20 mΩ max		50 mΩ max	
Insulation Resistance		500 MΩ min			
Withstanding Voltage		DC2500V 1 minute at 25°C (DC5000V Max **), AC2000Vrms 1 minute at 25°C (Between Drain and Source)			
Temperature Range		-55 to +175°C***		-55 to +220°C***	

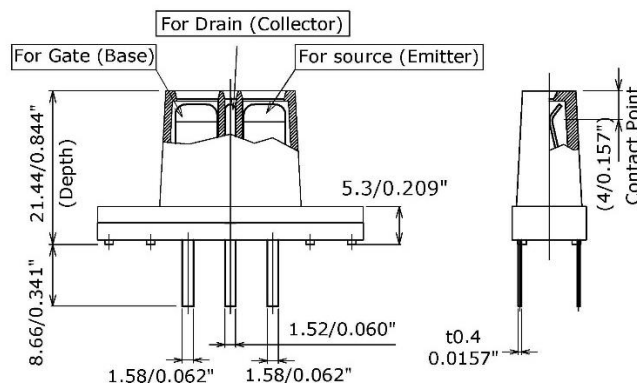
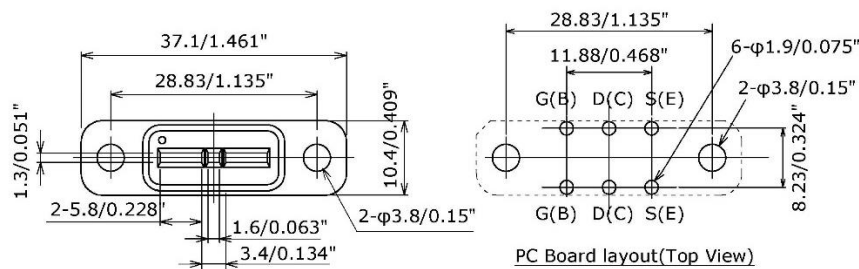
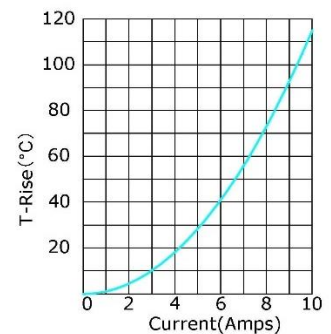
* Using a Standard Test Lead of ours ** There is use experience at DC5000V. Please contact us.

*** Includes temperature rise due to energization.

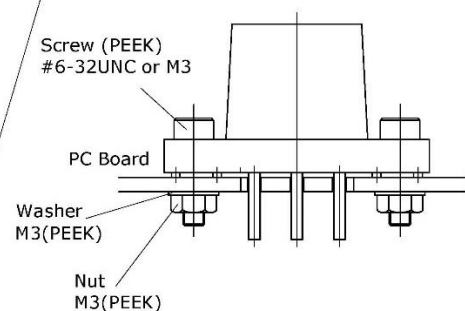
T3P-L214-ST-BK
T3P-L214-ST-BK-P
T-Rise Current Chart
(Reference)



T3P-L214-ST-HT
T3P-L214-ST-HT-P
T-Rise Current Chart
(Reference)



How to use



Vamtek 适配低 Ls 封装器件的测试夹具

随着数据中心，电动汽车等大功率电气装备广泛应用，以 SiC, GaN 为代表的全球第三代宽禁带半导体器件因为其可以适应更高频，更宽温区，更低开关损耗的应用要求而得到了非快的发展。

更低 Ls 的封装意味着更短的管脚，更多的管脚分布，更不通用的结构布局。

如何能更好的匹配新型封装器件，并符合半导体测试仪器的标准接口是行业的一大课题。

Vamtek 能够提供行业内绝大多数主流封装测试座，包括 TO-247-4, TO-263-7, TOLL, TOLG, TOLT, QDPAK, R2PAK 等，我们也将持续跟进市场主流品牌，持续同步更新更多更专业的测试座产品。



VAMTEK SMD 封装 Socket 型号选型表

安装形式	封装	产品型号 (长寿命金柱) 使用寿命: 10 万次	产品型号 (镀金弹片) 使用寿命: 1 万次
SMD	TO-252D-PAK	GD18-TO252-x-755	GU12-TO252-x-S74X68
	TO-263-3 D2-PAK	GD18-TO263-x-109	GU16-TO263-x-
	TO-263-7 D2-PAK	GD18-TO263-7-x-109	/
	TOLL	GD17-TOLL-x-XX	/
	TOLG	GD17-TOLG-x-S967X1012	/
	TOLT	GD21-TOLT-x-S103x101-FL	/
	QDPAK	GD26-QDPAK-x-S151x155	/
	HU3PAK	GD21-HU3PAK-x-S141X142	/
	R2PAK	GD21-R2PAK-x-S141X146	/

CX、KX 可选 TOLx 系列测试座产品型谱框架示意图：

TOLL  For TOLL(TO-Leadless) Package Test Sockets for SMD MOSFETs GD17-TOLL-x-xx	TOLT  For TOLT(TO-Leaded top-side cooling) Package Test Sockets for SMD MOSFETs GD21-TOLT-x-S103X101-FL	TOLG  TOLG(TO-Leaded with Gullwing) Test Sockets for SMD MOSFETs GD17-TOLG-x-S967X1012	HU3PAK  For HU3PAK Package Test Sockets for SMD MOSFETs GD21-HU3PAK-x-S141X142-xx	QDPAK  For QDPAK Package Test Sockets for SMD MOSFETs GD26-QDPAK-x-S151X155
R2PAK  For R2PAK Package Test Sockets for SMD MOSFETs GD21-R2PAK-x-S141X146-xx	 SLIT PIN for PC Board card edge High Temperature 250°C Pitch 5.08mm SLIT508-xxP-F09-Txx-PK	 SLIT PIN for PC Board card edge High Temperature 250°C Pitch 2.54mm SLIT254-xxP-F09-Txx-PK	 功率半导体封装用 模块化插座 高温型 最大220°C 最小间距 5.4mm PMS-5400P-S-HT	 功率半导体封装用 模块化插座 最大温度 175°C 最小间距 4mm PMS-4000P-S
TO-252 D-PAK  For TO-252/D-PAK Test Sockets for SMD MOSFETs Cost-effective Type GU12-TO252-x-S74X68	TO-252 D-PAK  For TO-252/D-PAK Test Sockets for SMD MOSFETs GD18-TO252-x-755	TO-263 D2-PAK  For TO-263/D2-PAK Test Sockets for SMD MOSFETs Cost-effective Type GU16-TO263-x-xxxxxxxx	TO-263 D2-PAK  For TO-263/D2-PAK Test Sockets for SMD MOSFETs GD18-TO263-x-109	TO-263-7 D2-PAK  For TO-263-7/D2-PAK Test Sockets for SMD MOSFETs GD18-TO263-7-x-109

TO-252 封装夹具 CAD 数据图

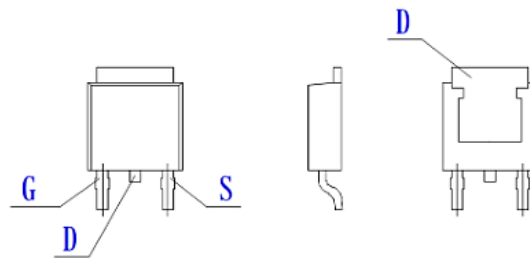
外形数据:

TO-252/D-PAK

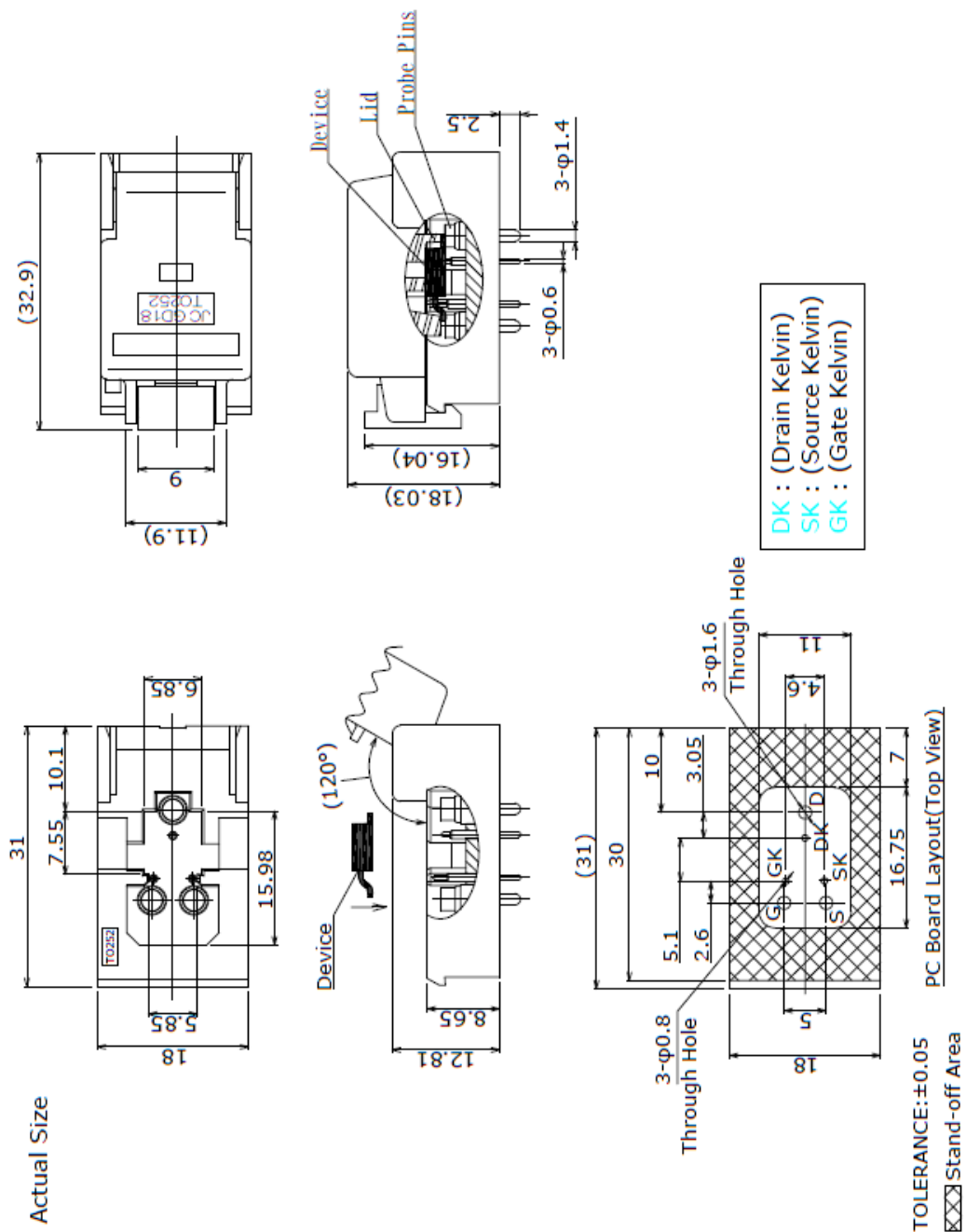
Terminal Pattern



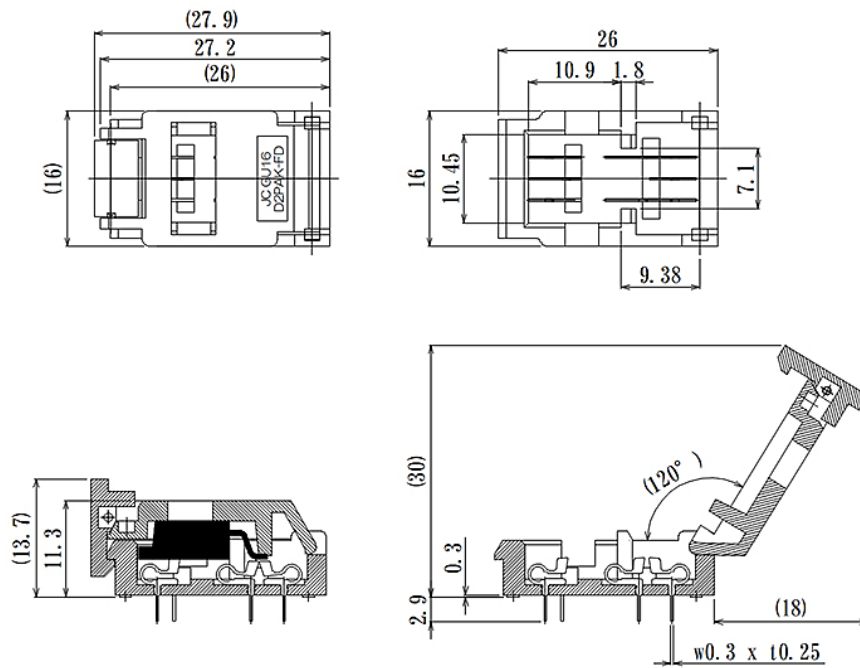
D : Drain
G : Gate
S : Source



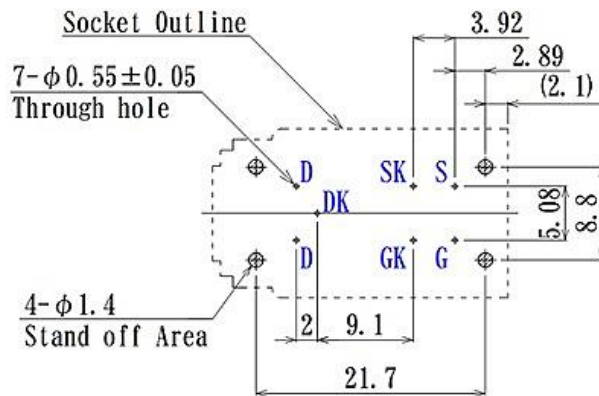
CAD 数据:



TO-263 封装 CAD 数据表 // GU16-TO263-K-L1090X103

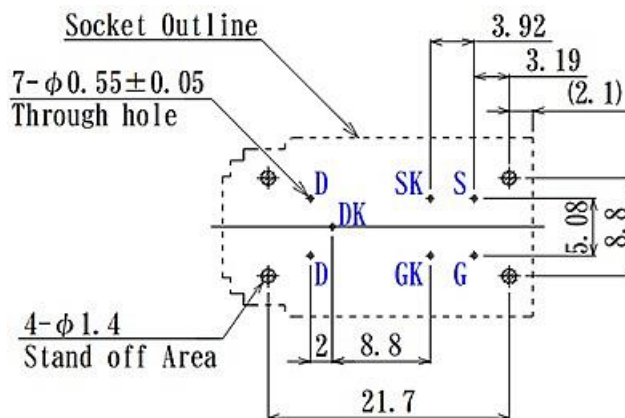


PC Board Layout(Top View)



DK : (Drain Kelvin)
SK : (Source Kelvin)
GK : (Gate Kelvin)

TO-263 封装 CAD 数据表 // GU16-TO263-K-S1045X103



DK : (Drain Kelvin)
SK : (Source Kelvin)
GK : (Gate Kelvin)

TO-263-7 封装 CAD 数据表 // GU16-TO263-K-L1090X103

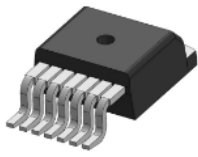
TO-263-7/D2-PAK

Terminal Pattern(Top View)

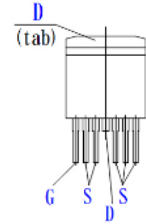
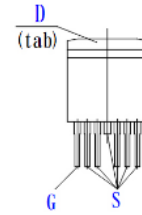
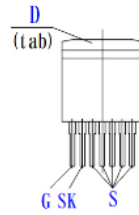
Pattern.A

Pattern.B

Pattern.C

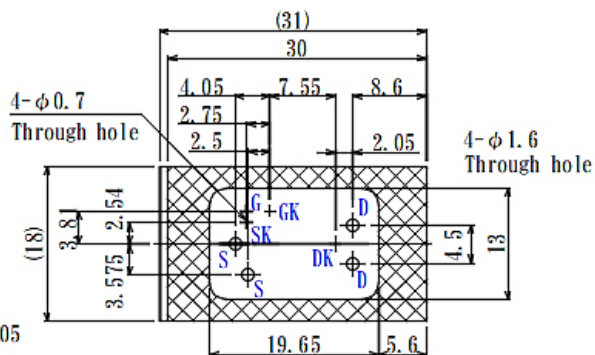
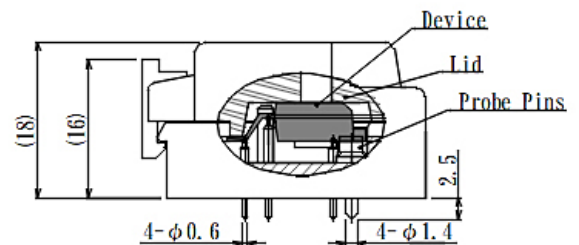
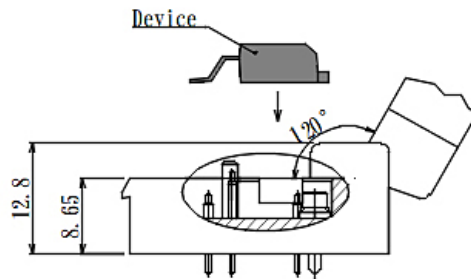
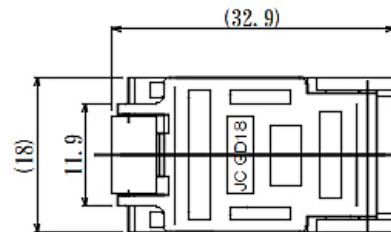
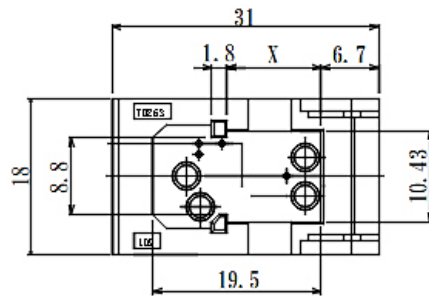


D : Drain
G : Gate
S : Source
SK : Kelvin Source

**GD18 - TO263-7 - □ - 109**TO-263-7
PackageCode
Please refer to the code table below.

N : No Kelvin Contact
K : With Kelvin Contact

Code	X
103	10.25
109	10.9

Tolerance: ± 0.05

Stand-off area

PC Board Layout (Top View)

DK : (Drain Kelvin)
SK : (Source Kelvin)
GK : (Gate Kelvin)

Acceptable Device Table by manufacturer // TO-263-7**GeneSiC SEMICONDUCTOR**

G3R450MT17J	G2R1000MT33J	G3R30MT12J
G3R75MT12J	G3R160MT12J	G3R350MT12J
G2R1000MT17J	G3R160MT17J	G3R40MT12J

Infineon

IPB039N10N3 G	IPB017N10N5ATMA1	IRFS7530TRL7PP
IPB015N08N5ATMA1	AUIRF2804S-7P	IPB030N08N3GATMA1
IPB020N10N5	IPB014N06NATMA1	AUIRFS8407-7P
AUIRFS8409-7P	IPB019N08N3G	AIMBG120R040M1
IPB016N06L3GATMA1	AUIRF1324S-7P	IPB009N03LGATMA1
AUIRFS8409-7P	IRF2804STRL7PP	IPB039N10N3GATMA1
PG-TO263-7-1	IPB020N04NGATMA1	AUIRFS8408-7P
IPB010N06NATMA1	AUIRF3805S-7P	IPB011N04LGATMA1
IPB017N06N3GATMA1	IRFS7430TRL7PP	IPB180N10S4-02
IPB180N04S4-H0	IPB025N10N3GATMA1	IPB011N04NGATMA1
TLE4271-2	AUIRFS3107-7P	
IMBF170R450M1XTMA1	AIMBG120R010M1	

ON Semiconductor

FDB0300N1007L	FDB0630N1507L	FDB1D7N10CL7
FDB0190N807L	FDB0165N807L	
FDB024N08BL7	FDB0170N607L	

ROHM

SCT3060AW7TL	SCT3160KW7TL	STH240N75F3-6
SCT3120AW7TL	SCT3080AW7TL	STH30N65DM6-7AG
SCT3030AW7TL	SCT3080KW7TL	STH240N10F7-6
BM2SC124FP2-LBZE2	SCT3105KW7TL	STH310N10F7-6
BM2SC121FP2-LBZE2	SCT4036KW7HRTL	STH320N4F6-6
BM2SC123FP2-LBZE2	STMicroelectronics	STH300NH02L-6

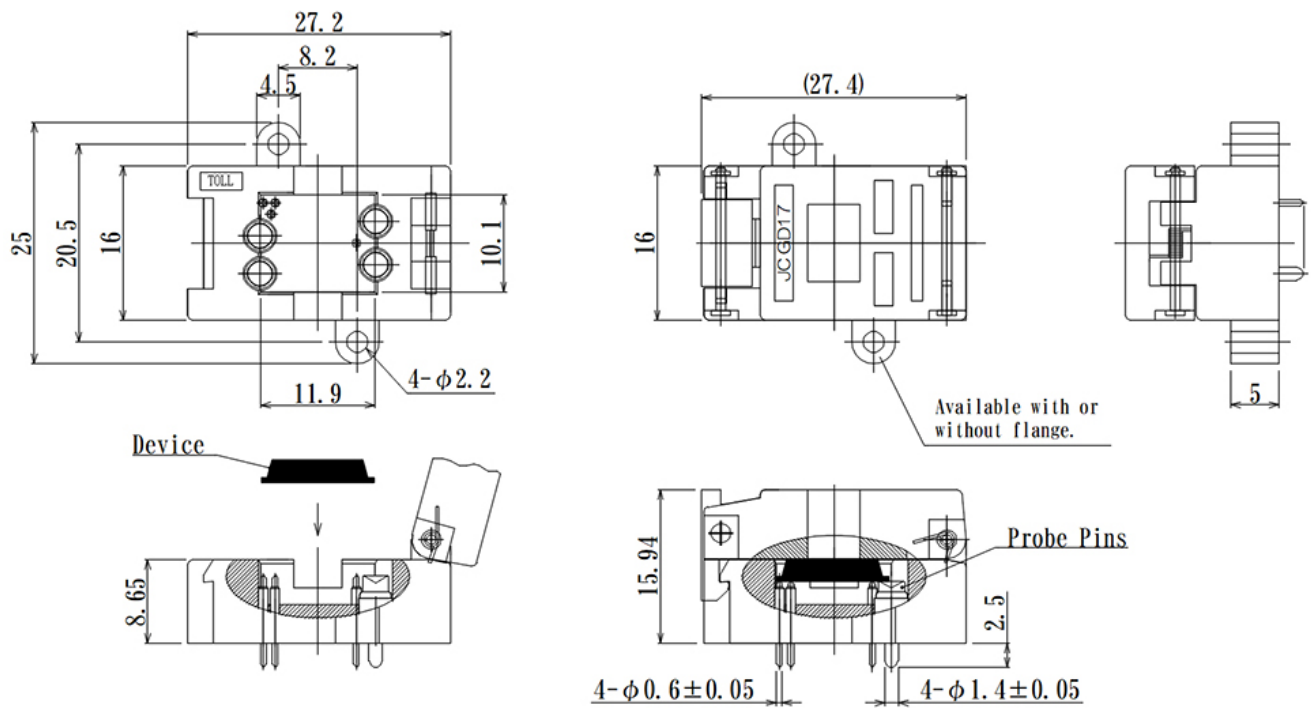
Vishay

SQM40016EM	SUM40014M-GE3	SQM200N04-1m7L_GE3
------------	---------------	--------------------

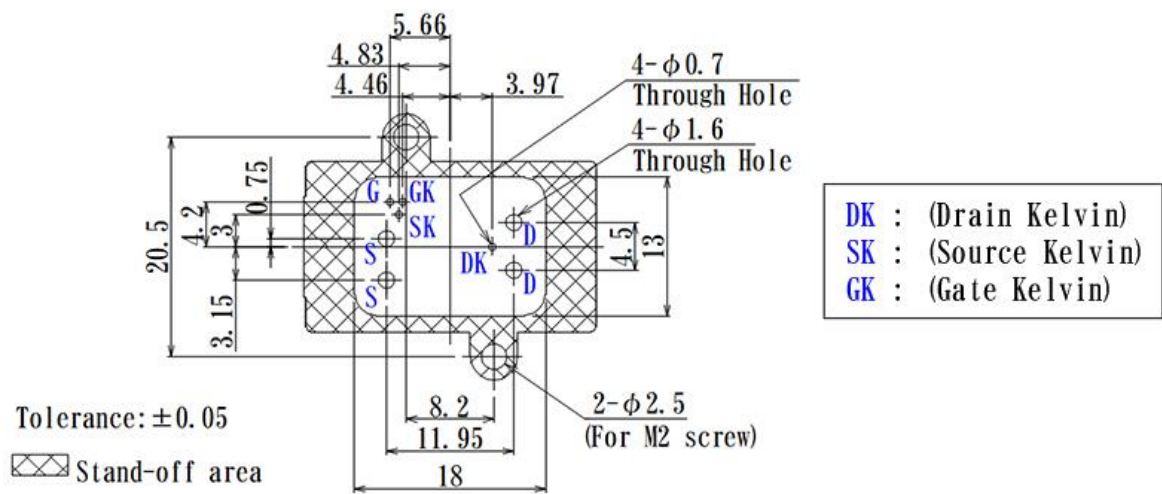
Wolfspeed(CREE)

C3M0065090J	C3M0280090J	C3M0120100J
C3M0065090J-TR	C3M0065100J	C2M1000170J
C3M0120090J	C3M0075120J	C3M0350120J

TOLL 封装【P/N: GD17-TOLL-K-FL】



PCB Layout(Top View)



Without Flange type (P/N:GD17-TOLL-x-NFL) does not require 2- $\phi 2.5$ holes.

Acceptable Device Table by manufacturer (Typical)
Generally,TOLL(TO-lead less) package size is specified.

However, the size depends on the semiconductor manufacturers and devices.
If you send us your device in advance,we can properly confirm its adoption.

Alpha & Omega Semiconductor

AOTL095A60

AOTL125A60

AOTL42A60E

Infineon

IPT019N08N5	IPT030N12N3 G	IPLU300N04S4-R8
IPT210N25NFD	IPT012N08N5	IPLU300N04S4-1R1
IPT111N20NFD	IPT013N08NM5LF	IPLU250N04S4-1R7
IPT029N08N5	IPT008N06NM5LF	IAUT300N08S5N012
PT007N06N	IPT044N15N5	IAUT165N08S5N029
IPT014N08NM5	IPT039N15N5	IAUT300N08S5N014
IPT026N10N5	IPT010N08NM5	IAUT240N08S5N019
IPT015N10N5	IPT063N15N5	IAUT200N08S5N023
IPT012N06N	IPT020N10N3	IAUT300N10S5N015
IPT054N15N5	IPT059N15N3	IAUT150N10S5N035
IPT020N10N5	IPT004N03L	IAUT260N10S5N019

ON Semiconductor

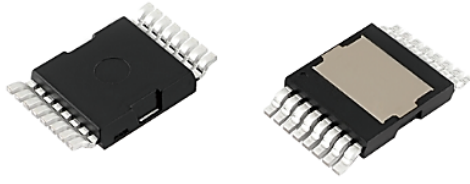
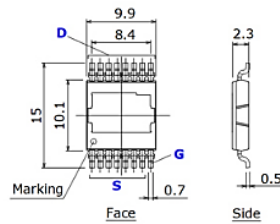
FDBL0065N40	FDBL86066-F085	NTBLS1D5N08MC
FDBL0090N40	FDBL86210_F085	NTBLS1D5N10MC
FDBL0110N60	FDBL86361_F085	NTBLS1D7N08H
FDBL0120N40	FDBL86363_F085	NTBLS1D7N10MC
FDBL0150N60	FDBL86366_F085	NTBLS4D0N15MC
FDBL0150N80	FDBL86561_F085	NVBLS011N06C
FDBL0200N100	FDBL86563_F085	NVBLS0D5N04C
FDBL0210N80	FDBL86566_F085	NVBLS0D7N06C
FDBL0240N100	FDBL9401-F085T6	NVBLS1D1N08H
FDBL0260N100	FDBL9403-F085T6	NVBLS1D5N10MC
FDBL0330N80	FDBL9406-F085T6	NVBLS1D7N08H
FDBL0630N150	NTBLS001N06C	NVBLS1D7N10MC
FDBL86062_F085	NTBLS002N08MC	NVBLS4D0N15MC
FDBL86063	NTBLS0D7N06C	
FDBL86063_F085	NTBLS1D1N08H	

STMicroelectronics

ST024N60M6	ST047N60M6	ST065N60DM6
ST033N60M6	ST067N60M6	ST067N60DM6
ST036N60M6	ST052N60DM6	ST068N65DM6

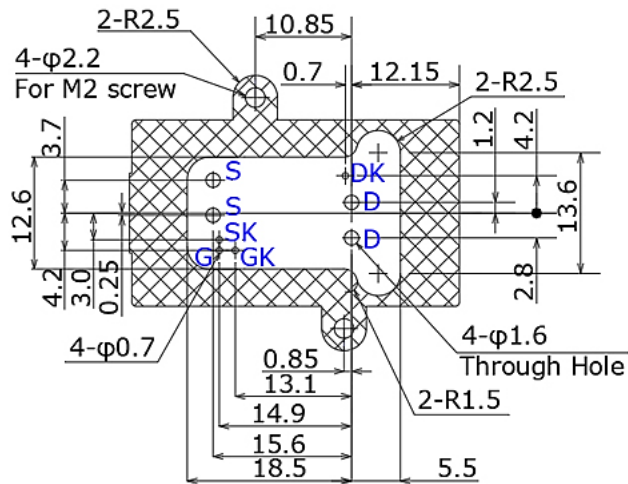
Toshiba

TK065U65Z	TK110U65Z
TK090U65Z	TK155U65Z

TOLT 封装【P/N: GD21-TOLT-x-S103X101-FL】**TOLT(TO-Leaded top-side cooling)****Terminal Pattern**

D : Drain
G : Gate
S : Source

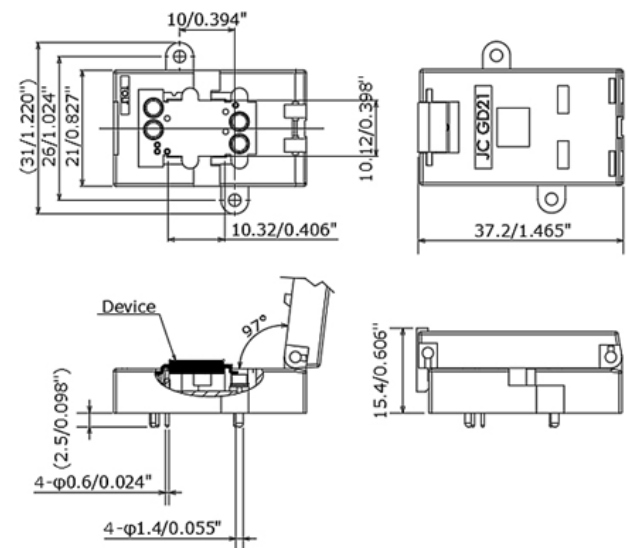
Also possible to support other terminal patterns.
 Please contact us for more details.

PCB Layout TOP View :

DK : (Drain Kelvin)
SK : (Source Kelvin)
GK : (Gate Kelvin)

电气规格:

接触电阻	最大 50mΩ
额定电流	25℃ 时为 12A (漏极和源极之间) * 室温, T-Rise 为 30℃
耐压	DC2000V 25℃ 下 1 分钟
绝缘电阻	DC500V 时为 500MΩmin
工作温度	-40℃ 至 +200℃ **

**Acceptable Device Table(Typical)****Infineon**

IPTC012N06NM5

IPTC014N08NM5

IPTC063N15NM5

IPTC007N06NM5

IPTC019N10NM5

IPTC039N15NM5

IPTC044N15NM5

IPTC014N10NM5

IPTC020N13NM6

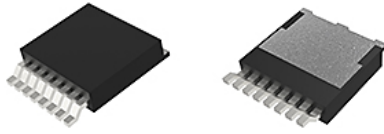
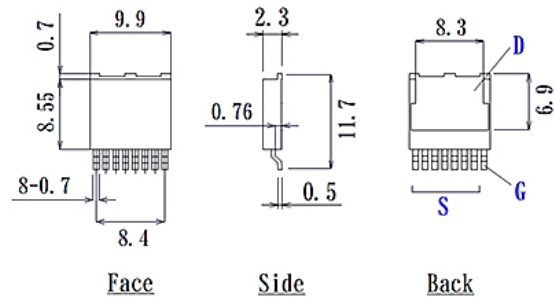
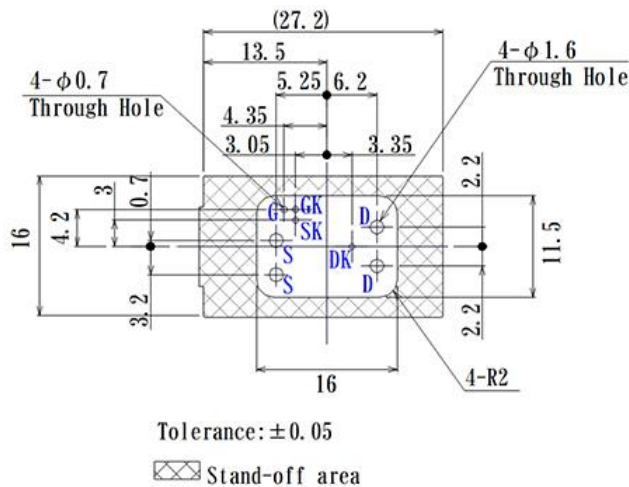
IPTC011N08NM5

IPTC026N12NM6

IPTC054N15NM5

IPTC017N12NM6

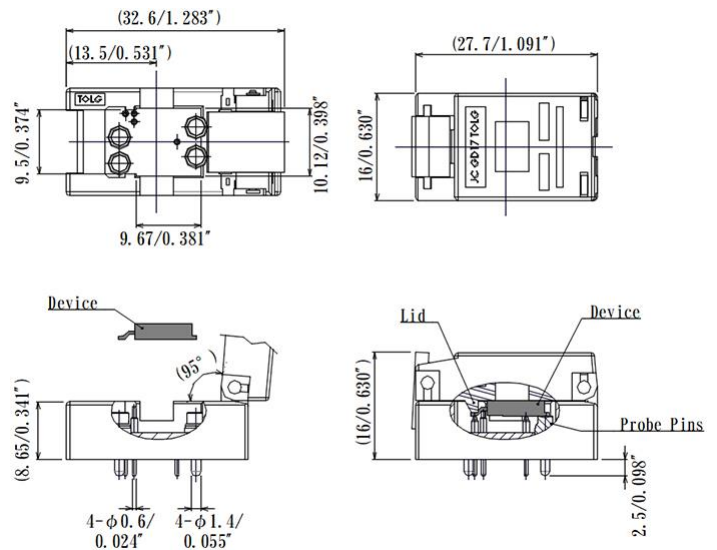
通常, 指定 TOLL (TO-less) 封装尺寸。

TOLG 封装【P/N: GD17-TOLG-x-S967X1012】**TOLT(TO-Leaded top-side cooling)****Terminal Pattern****PCB Layout TOP View**

DK : (Drain Kelvin)
SK : (Source Kelvin)
GK : (Gate Kelvin)

电气规格:

接触电阻	最大 50mΩ
额定电流	25°C 时为 12A (漏极和源极之间) * 室温, T-Rise 为 30°C
耐压	DC2000V 25°C 下 1 分钟
绝缘电阻	DC500V 时为 500MΩmin
工作温度	-40°C 至 +200°C **



Acceptable Device Table(Typical)
Infineon

IPTG044N15NM5
 IAUS300N08S5N011
 IPTG111N20NM3FD
 IPTG025N10NM5
 IPTG210N25NM3FD
 IPTG014N10NM5
 IPTG007N06NM5
 IPTG029N13NM6

IPTG018N10NM5
 IPTG025N08NM5
 IPTG020N13NM6
 IAUS300N10S5N014
 IPTG011N08NM5
 IAUTN06S5N008G
 IAUTN12S5N018G
 IAUS300N08S5N012

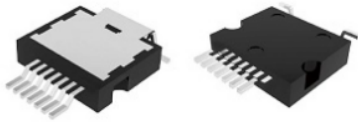
IPTG017N12NM6
 IAUS240N08S5N019
 IPTG054N15NM5
 IAUS200N08S5N023
 IPTG039N15NM5
 IAUS300N08S5N014
 IPTG063N15NM5
 IAUS165N08S5N029

通常, 指定 TOLL (TO-less) 封装尺寸。

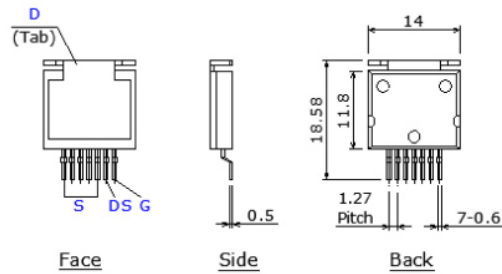
HU3PAK 封装

【P/N: GD21-HU3PAK-x-S141X142-xx】

HU3PAK Package

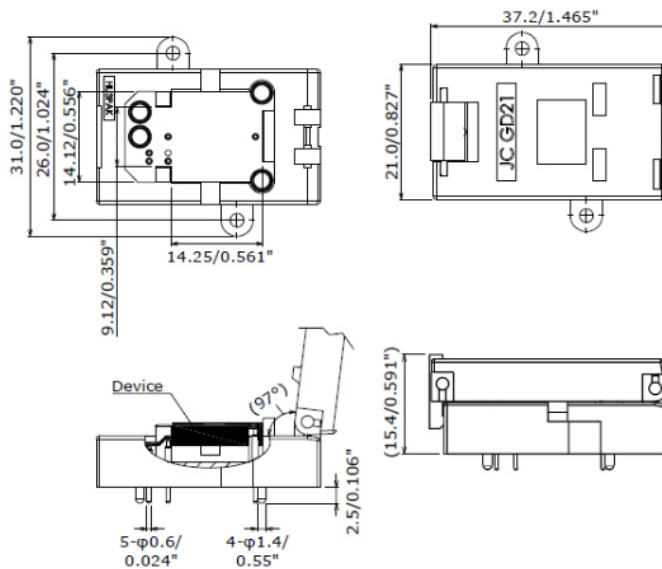


Terminal Pattern

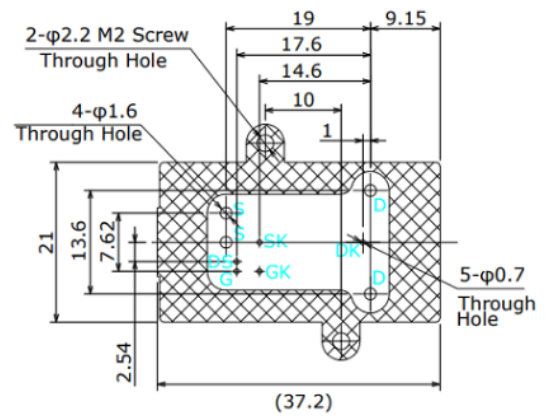


D : Drain
G : Gate
DS : Driver
Source
S : Source

PCB Layout TOP View



PC Board Layout(Top View)



PC Board Layout(Top View)
Tolerance: ± 0.05 Stand-off area

Acceptable Device Table(Typical)

STMicroelectronics

SCT040HU65G3AG
SCT020HU120G3AG
SCT055HU65G3AG
SCT060HU75G3AG
SCT014HU65G3AG

SCT070HU120G3AG
STHU32N65DM6AG
STHU36N60DM6AG
STHU47N60DM6AG
STTH30RQ06L2

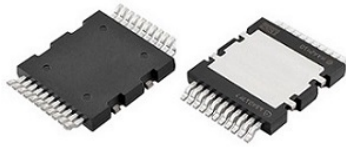
STTH30RQ06L2Y
TN3050HP-12L2Y
TN4050HP-12L2Y

器件尺寸因半导体制造商和产品而异。

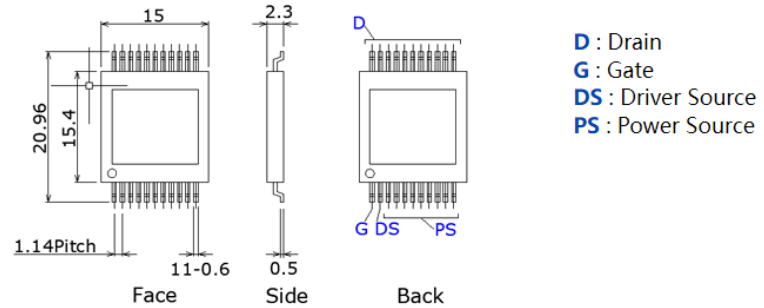
QDPAK 封装

【P/N: GD26-QDPAK-x-S151X155】

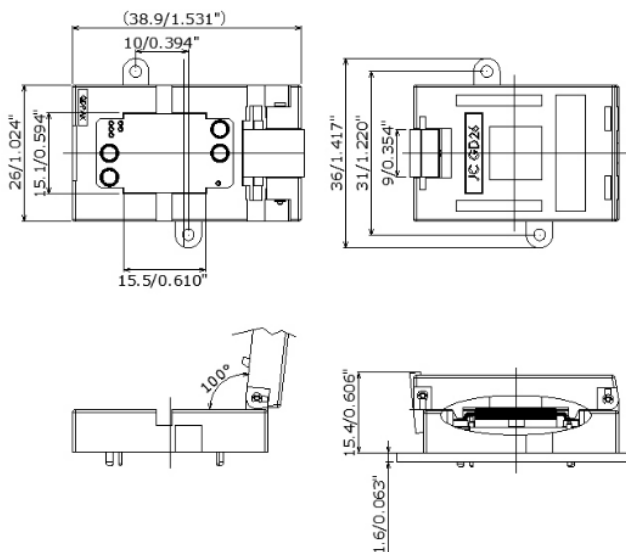
QDPAK Package



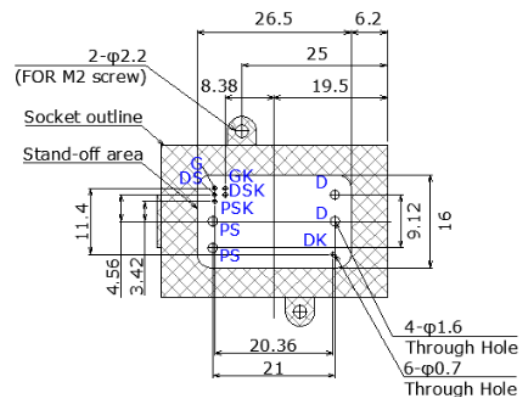
Terminal Pattern



PCB Layout TOP View

GD26 - QDPAK - □ - S151X155QDPAK
PackageDevice Guide size
15.1x15.5mm**N** : No Kelvin Contact
K : With Kelvin Contact

PC Board Layout(Top View)

PC Board Layout (Top View)
Tolerance: ±0.05

DK : (Drain Kelvin)
PS : (Power Source)
PSK : (Power Source Kelvin)
DS : (Driver Source)
DSK : (Driver Source Kelvin)
GK : (Gate Kelvin)

Acceptable Device Table(Typical)

Infineon

AIMCQ120R080M1T

AIMCQ120R020M1T

AIMDQ75R060M1H

AIMCQ120R120M1T

AIMDQ75R027M1H

AIMCQ120R060M1T

AIMCQ120R160M1T

AIMCQ120R030M1T

AIMDQ75R090M1H

AIMDQ75R016M1H

AIMDQ75R040M1H

AIMDQ75R140M1

AIMDQ75R020M1H

AIMCQ120R040M1T

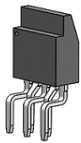
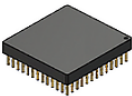
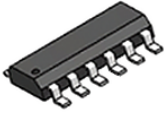
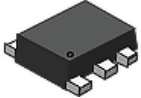
器件尺寸因半导体制造商和产品而异。

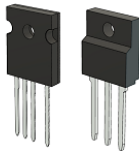
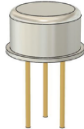
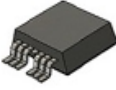
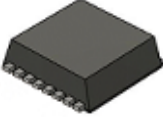
附录：半导体封装的分类与适配选型目录：

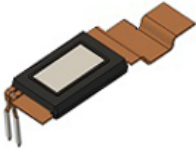
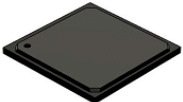
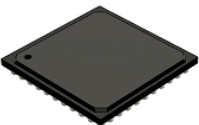
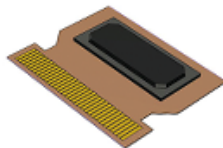
我们设计和制造与各种半导体封装（如 DIP 、SMD、PGA、BGA、QFN）和各种 TO 封装兼容的测试插座和老化插座。

我们提供定制和半定制插座设计，以满足您的设备尺寸和使用条件。

此外，我们还提供 PCB 工装设计和制造服务，让您可以全面订购插座和 PCB 工装夹具。

封装分类	封装名	外观	夹具型号	工装型号
SIP	Single In-line Package			
ZIP	Zigzag In-line Package			
DIP	Dual In-line Package		GU78-DIPseries	
	SDIP (Shrink DIP)			
PGA	Pin Grid Array		Adapter Sockets Image Sensor Sockets Image Sensor Vacuum Socket	
SOP	Small Outline Package		Direct Contact Socket GU15 Frame series GQ Frame series	
	TSOP (Thin SOP)			
	SSOP (Shrink SOP)			
SON	Small Outline Non-leaded Package		GU15 Frame series	
SOJ	Small Outline J-leaded Package		GU15 Frame series	

SOT	Small Outline Transistor			
TO	Transistor Outline		Sockets for Power Transistor	
	CAN Type, Metal Package		Laser Diode Sockets	
	TO-252/ D-PAK		GU12-TO252-K-S74X68 GD18-TO252-x-755	
	TO-263/ D2-PAK	  3Pin 7Pin	GU16-TO263-K-GD18-TO263-x-109 GD18-TO263-7-x-109	
	TO-263 Thick Film Resistors			
	TO-277A			
	TO-Leadless (HSOF-8)		GD17-TOLL-x-xx	
	TOLG (HSOG-8)		GD17-TOLG-x-S967X1012	
LFPAK	Loss Free Package			
HU3PAK			GD25-HU3PAK-x-S141X142	

STPAK				
QFP	Quad Flat Package		GGT18 Series Direct Contact Socket	
LGA	Land Grid Array		System Level Test For LGA Final Test For LGA Burn-In Test For LGA	
BGA	Ball Grid Array		System Level Test For BGA Burn-In Test For BGA	
	FBGA(CSP) (Fine pitch BGA)			
	TFBGA (Thin FBGA)			
	VFBGA (Very thin FBGA)			
QFN	Quad Flat Non-leaded Package		System Level Test For QFN Burn-In Test For QFN	
	CQFN (Ceramic QFN)			
	Wettable Flanks QFN			
QFJ	Quad Flat J-leaded Package			
	PQFJ (Plastic QFJ)			
TCP	Tape Carrier Package			

Vamtek



IWATSU 为岩崎通信机株式会社商标；KEYSIGHT 为美国是德科技商标。

长沙力高捷创仪器有限公司 出品

网址：www.jectronic.com